

RA2L1 グループ

タッチレスボタン電極ボード サンプルソフトウェア

要旨

本アプリケーションノートでは、タッチ電極と人体の間に発生する静電容量を測定することで人体の接触を感知するハードウェア Capacitive Touch Sensing Unit2（以下、CTS U2）の自己容量方式による応用事例として、タッチレスボタン電極ボードのソフトウェア仕様を説明します。

動作確認デバイス

RA2L1 グループ

関連ドキュメント

1. RA ファミリ QE と FSP を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発 (R01AN4934)
2. 静電容量センサマイコン タッチレスボタン電極ボード (R12AN0115)
3. RA2L1 グループ 静電容量タッチ評価システム ユーザーズマニュアル (R12UZ0084)
4. RA2L1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0853)

目次

1. 概要	2
2. 動作環境	4
3. ソフトウェア構成	5
4. ファイル構成	6
5. サンプルアプリケーション	7
5.1. 動作概要	7
5.2. タッチインタフェース構成	8
5.3. チューニング値の変更	9
5.3.1. 電流モードの変更	9
5.3.2. 閾値の変更	9
5.4. LED 点灯	11
5.5. サウンド出力	12
改訂記録	13

1. 概要

本アプリケーションノートでは、静電容量タッチ検出を応用したタッチレスボタン電極ボードで動作するサンプルソフトウェアに関して説明します。

本ソフトウェアはサンプルアプリケーションを含む e² studio プロジェクト形式で提供しています。

静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch（以降、QE）と FSP ミドルウェア、ドライバを使用した、通常のタッチボタンと同様のファイル構成です。

通常のタッチボタンは指を電極にタッチして QE での調整をしますが、指を電極から浮かせた状態で QE での調整をすることでタッチレスボタンの設定ができます。治具などを使用して固定すれば適切な調整ができますが、これができない場合は QE 出力ファイルを修正して閾値を設定することも可能です。本ソフトウェアは後者の設定をしています。

タッチレスボタン電極ボードの仕様については関連ドキュメント「静電容量センサマイコン タッチレスボタン電極ボード (R12AN0115)」を参照してください。

タッチレスボタン電極ボードは筐体有無の 2 種類の形態があり、図 1.1 にそれぞれ CPU ボードと接続した状態を示します。

サンプルソフトウェアでは筐体あり標準設定の構成で作成しており、4 電極用、9 電極用、12 電極用の 3 種類を作成しています。

筐体あり標準設定については関連ドキュメント「静電容量センサマイコン タッチレスボタン電極ボード (R12AN0115)」の「2.1 製品構成(筐体あり)」を参照してください。

筐体あり標準設定以外の構成、筐体なしの構成とする場合は、各電極用のプロジェクトを再チューニングしてください。



図 1.1 タッチレスボタン電極ボード（左：筐体あり、右：筐体なし）

タッチレスボタン電極ボードでは、図 1.2 に示すように、タッチを検出するボードは電極を取り換えられる構造を採用しています。亚克力板の裏にタッチ電極を取り付け、手を近づけるなどして検出されたカウント値からタッチ判断を行います。

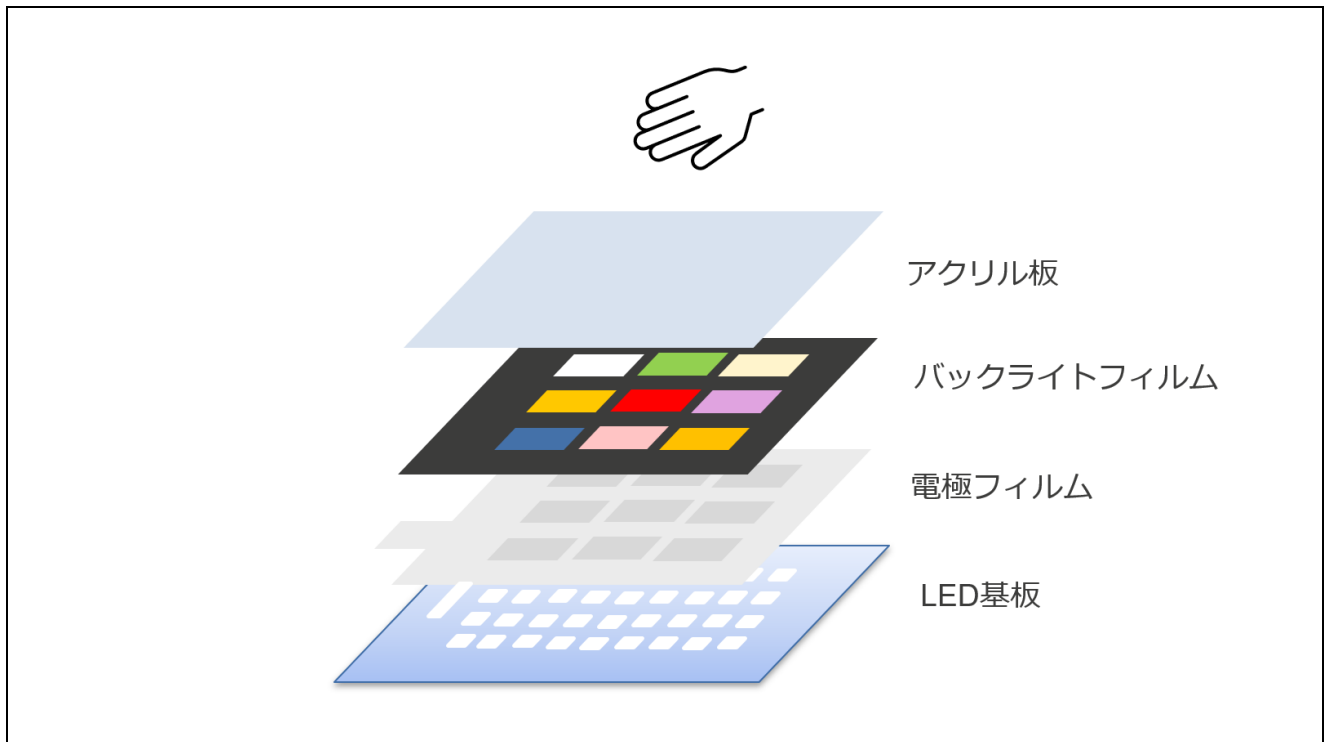


図 1.2 タッチレスボタン電極ボード構造

2. 動作環境

表 2.1、表 2.2 に筐体有無それぞれのソフトウェア動作環境を示します。

表 2.1 動作環境 1

項目	内容
CPU ボード	RA2L1 グループ 静電容量タッチ評価システム CPU ボード (RTK0EG0018C01001BJ)
電極ボード	タッチレスボタン電極ボード (筐体あり) (RTK0ES1001D01001BJ)
マイコン	RA2L1
動作周波数	48MHz
動作電圧	5.0 V
統合開発環境	e ² studio Version: 2021-10 (21.10.0)
C コンパイラ	GCC ARM Embedded 9.3.1.20200408
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール	QE for Capacitive Touch V2.0.0

表 2.2 動作環境 2

項目	内容
CPU ボード	RA2L1 グループ 静電容量タッチ評価システム CPU ボード (RTK0EG0018C01001BJ)
電極ボード	タッチレスボタン電極ボード (筐体なし) (RTK0ES1001D02001BJ)
マイコン	RA2L1
動作周波数	48MHz
動作電圧	5.0 V
統合開発環境	e ² studio Version: 2021-10 (21.10.0)
C コンパイラ	GCC ARM Embedded 9.3.1.20200408
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール	QE for Capacitive Touch V2.0.0

3. ソフトウェア構造

図 3.1 にソフトウェア構造図を示します。

rm_touch ミドルウェアは r_ctsu ドライバでの静電容量計測結果から、タッチを検出します。

アプリケーションは、タッチレスボタン電極ボードの LED 点灯とサウンド出力によって、ユーザにタッチの検出結果を通知します。

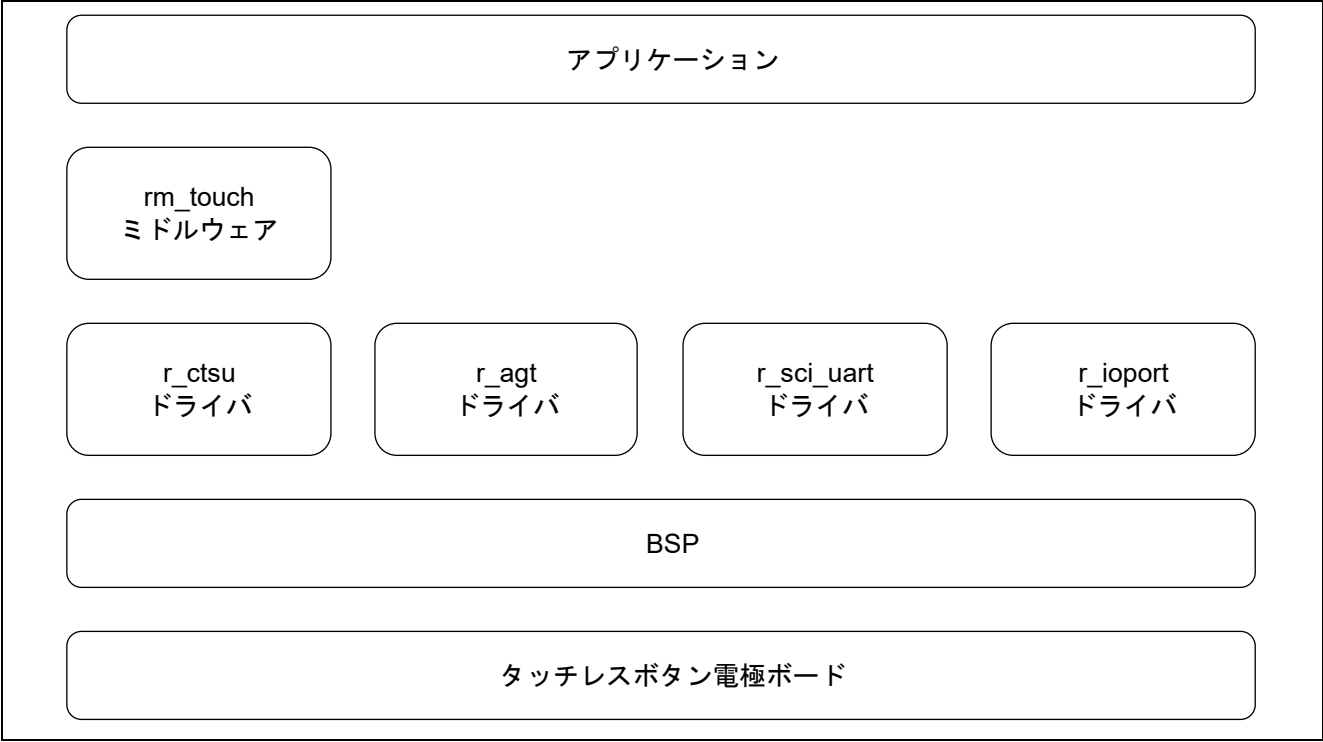


図 3.1 ソフトウェア構造図

本ソフトウェアで使用している FSP ミドルウェア、及びドライバのバージョンを表 3.1 に示します。

表 3.1 FSP ミドルウェア・ドライバのバージョン

FSP ミドルウェア、ドライバ	バージョン
BSP	3.4.0
r_ctsu	3.4.0
rm_touch	3.4.0
r_ioport	3.4.0
r_agt	3.4.0
r_sci_uart	3.4.0

4. ファイル構成

本ソフトウェアのファイル構成と RA コンフィグレータ生成ファイルからの変更内容を表 4.1 に示します。

FSP ミドルウェア、ドライバは変更していません。FSP ミドルウェア、ドライバについてはそれぞれのドキュメントを参照してください。

表 4.1 ファイル構成

フォルダ/ファイル名	変更内容
プロジェクト	-
qe_gen	-
qe_touch_config.c	チューニング値の調整
qe_touch_config.h	-
qe_touch_define.h	-
qe_touch_sample.c	サンプルアプリケーション
ra (ファイル構成省略)	-
ra_cfg (ファイル構成省略)	-
ra_gen (ファイル構成省略)	-
src	-
hal_entry.c	サンプルアプリケーション・コール
r_touchless_led_board.c	LED/サウンド出力アプリケーション

5. サンプルアプリケーション

サンプルアプリケーションについて説明します。

5.1. 動作概要

本ソフトウェアの動作概要を図 5.1 に示します。

1. 電源投入後、初期設定します。
2. オフセットチューニングが正常終了した場合、電極構成に合わせて 1 秒間 LED 点灯し、消灯します。（異常の場合は LED が点滅し、リセットするまで止まりません。）
3. LED 消灯後、タッチ計測ループとなり、タッチを判定します。複数のタッチ検出には対応していません。
4. タッチ検出した場合、LED 点灯とサウンド出力をします。LED 点灯は「5.4 LED 点灯」、サウンド出力は「5.5 サウンド出力」を参照してください。

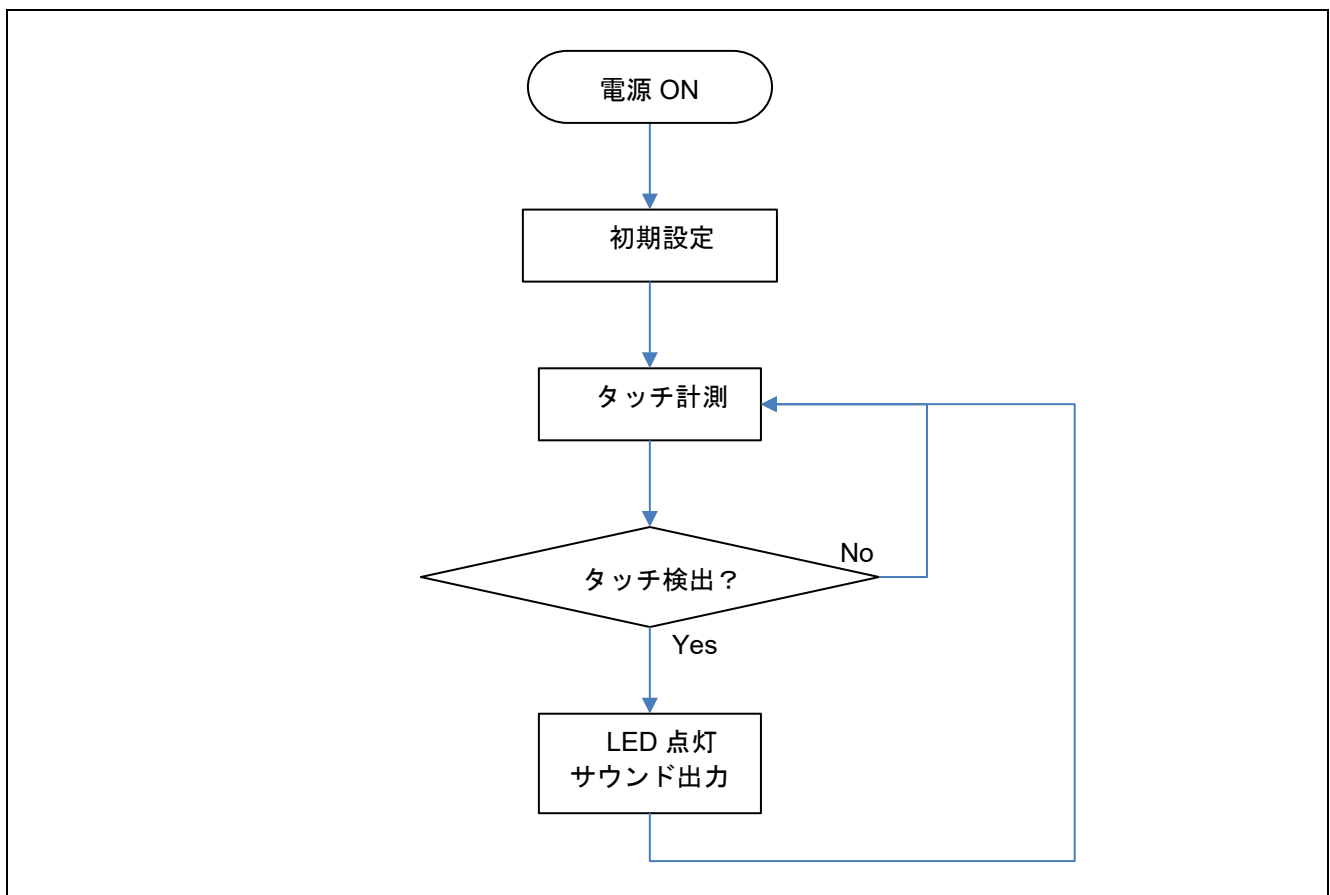


図 5.1 動作概要

5.2. タッチインタフェース構成

本ソフトウェアでは図 5.2 のように TS 端子を設定しています。
 本ソフトウェアではシールド基板の設定によりタッチインタフェース構成を 2 種類用意しています。シールド端子に割り当てられている TS06 を CTSU2 の機能であるアクティブシールドとして設定した「touchless_electrode_sample_project_ra2l1_xxe.tifcfg」と、GPIO で Low 固定に設定した「touchless_electrode_sample_project_ra2l1_xxe_Low.tifcfg」があり、デフォルトでは前者に設定しています。筐体なし版を評価する場合は後者に設定し、CapTouch メイン(QE)画面から“2.調整”の“ファイルを出力”を選択し、ファイルを更新してください。



図 5.2 タッチインタフェース構成

5.3. チューニング値の変更

5.3.1. 電流モードの変更

本ソフトウェアでは QE の「高度な設定」を使用し、電流モードを変更しています。電流モードの設定により、発振器に流れる計測電流比を変更することが可能です。電流モードの詳細については、「RA2L1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0853)」の ATUNE1 ビット、ATUNE2 ビットに関する説明をご参照ください。自己容量方式ではデフォルトで 40uA に設定されますが、本ソフトウェアでは 20uA に変更しています。

5.3.2. 閾値の変更

サンプルソフトウェアでは QE 出力ファイル `qe_touch_config.c` の閾値とヒステリシスを変更しています。表 5.1、表 5.2、表 5.3 に各電極構成で変更した変数名と設定値、その電極のタッチ検出距離を示します。各値は筐体あり版の「touchless_electrode_sample_project_ra2l1_xxe.tifcfg」のインタフェース構成の値を記載しています。筐体なし版や「touchless_electrode_sample_project_ra2l1_xxe_Low.tifcfg」インタフェース構成を評価する場合は再チューニングしてください。

表 5.1 変更定数とタッチ検出距離（4 電極）

変数名	設定値	タッチ検出距離	
		指 1 本 (mm)	手のひら (mm)
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[0].threshold</code>	190	40	50
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[0].hysteresis</code>	9		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[1].threshold</code>	160		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[1].hysteresis</code>	7		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[2].threshold</code>	150		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[2].hysteresis</code>	7		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[3].threshold</code>	180		
<code>g_qe_touch_button_cfg_config01[3].hysteresis</code>	9		

表 5.2 変更変数とタッチ検出距離 (9 電極)

変数名	設定値	タッチ検出距離	
		指 1 本 (mm)	手のひら (mm)
g_qe_touch_button_cfg_config01[0].threshold	270	30	40
g_qe_touch_button_cfg_config01[0].hysteresis	13		
g_qe_touch_button_cfg_config01[1].threshold	305		
g_qe_touch_button_cfg_config01[1].hysteresis	15		
g_qe_touch_button_cfg_config01[2].threshold	280		
g_qe_touch_button_cfg_config01[2].hysteresis	13		
g_qe_touch_button_cfg_config01[3].threshold	255		
g_qe_touch_button_cfg_config01[3].hysteresis	12		
g_qe_touch_button_cfg_config01[4].threshold	270		
g_qe_touch_button_cfg_config01[4].hysteresis	13		
g_qe_touch_button_cfg_config01[5].threshold	290		
g_qe_touch_button_cfg_config01[5].hysteresis	14		
g_qe_touch_button_cfg_config01[6].threshold	225		
g_qe_touch_button_cfg_config01[6].hysteresis	11		
g_qe_touch_button_cfg_config01[7].threshold	245		
g_qe_touch_button_cfg_config01[7].hysteresis	12		
g_qe_touch_button_cfg_config01[8].threshold	280		
g_qe_touch_button_cfg_config01[8].hysteresis	13		

表 5.3 変更変数とタッチ検出距離 (12 電極)

変数名	設定値	タッチ検出距離	
		指 1 本 (mm)	手のひら (mm)
g_qe_touch_button_cfg_config01[0].threshold	290	20	30
g_qe_touch_button_cfg_config01[0].hysteresis	14		
g_qe_touch_button_cfg_config01[1].threshold	215		
g_qe_touch_button_cfg_config01[1].hysteresis	11		
g_qe_touch_button_cfg_config01[2].threshold	200		
g_qe_touch_button_cfg_config01[2].hysteresis	10		
g_qe_touch_button_cfg_config01[3].threshold	205		
g_qe_touch_button_cfg_config01[3].hysteresis	10		
g_qe_touch_button_cfg_config01[4].threshold	220		
g_qe_touch_button_cfg_config01[4].hysteresis	11		
g_qe_touch_button_cfg_config01[5].threshold	245		
g_qe_touch_button_cfg_config01[5].hysteresis	12		
g_qe_touch_button_cfg_config01[6].threshold	300		
g_qe_touch_button_cfg_config01[6].hysteresis	14		
g_qe_touch_button_cfg_config01[7].threshold	200		
g_qe_touch_button_cfg_config01[7].hysteresis	10		
g_qe_touch_button_cfg_config01[8].threshold	250		
g_qe_touch_button_cfg_config01[8].hysteresis	12		
g_qe_touch_button_cfg_config01[9].threshold	265		
g_qe_touch_button_cfg_config01[9].hysteresis	13		
g_qe_touch_button_cfg_config01[10].threshold	220		
g_qe_touch_button_cfg_config01[10].hysteresis	11		
g_qe_touch_button_cfg_config01[11].threshold	210		
g_qe_touch_button_cfg_config01[11].hysteresis	10		

5.4. LED 点灯

LED 基板には LED が搭載されており、4 電極、9 電極、12 電極のボタン構成に合わせて、タッチした電極の場所を点灯します。

LED 制御ポートと各電極の対応は図 5.3 のようになっています。

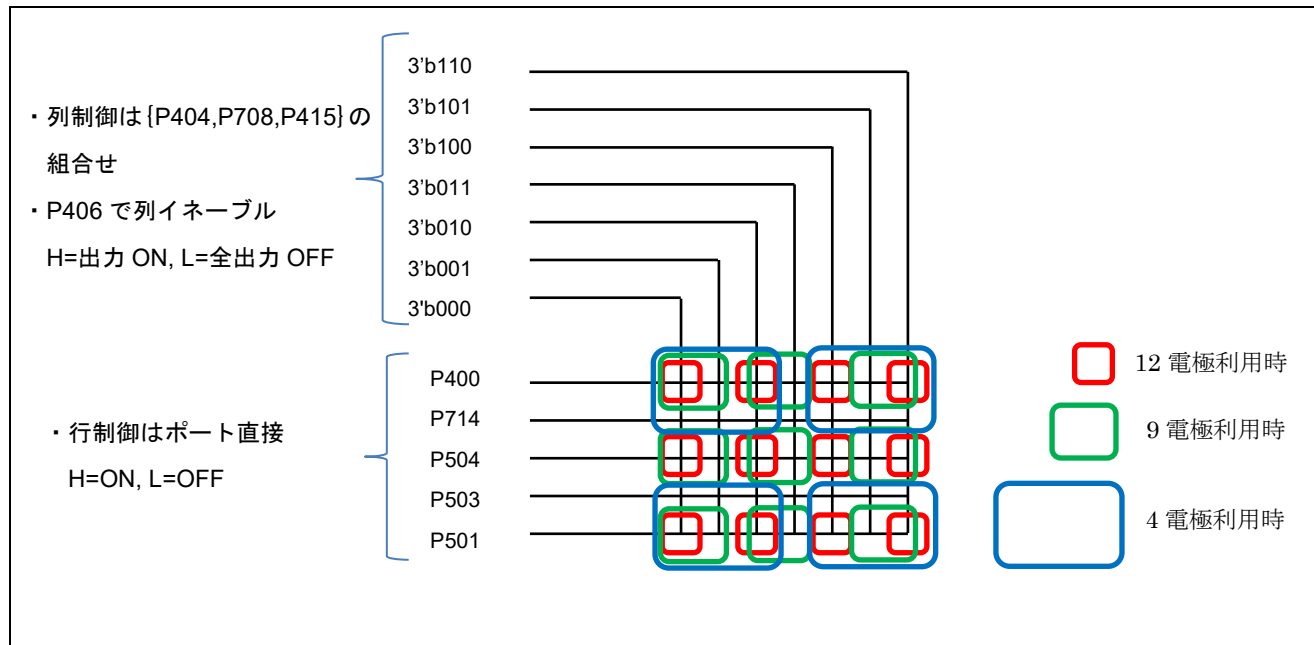


図 5.3 LED 制御ポートと各電極の対応

LED 制御ポートは図 5.3 のように 5×7 のマトリクスで構成されており、タイマを使用したダイナミック点灯により実現しています。

タッチ判定は 20ms 間隔のタッチ計測周期で実施していて、RM_TOUCH_DataGet()でタッチステータスをグローバル変数に保存します。

LED ダイナミック点灯用のタイマ割り込みで上記のグローバル変数を確認し、タッチ判定されたボタンの LED のみ点灯させます。

表 5.4 に LED 点灯用タイマ設定を示します。

表 5.4 LED 点灯用タイマ設定

タイマ	タイマ周期	ポート切り替え回数	合計周期
AGT	250us	7	1750us

5.5. サウンド出力

LED 基板にはブザーが搭載されており、タッチに応じてサウンドを出力します。

サウンド出力用のポートは 2 つありますが、本サンプルソフトウェアでは P502 を使用しています。

ポートから特定周波数(音階の「ド」を出力する周波数 = 523Hz)で一定時間 H/L を繰り返すことで、ブザーからサウンド出力できるため、タイマを使用して H/L 出力を行います。

LED 点灯と同様に、タイマ割り込みでグローバル変数を確認してサウンドを出力します。全てのボタンで同じサウンドです。

表 5.5 にサウンド出力用タイマ設定を示します。

表 5.5 サウンド出力用タイマ設定

タイマ	タイマ周期	H/L 周期
AGT	956us	1912us

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2021.11.10	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとしします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。